

应用示例

陶瓷基体上的扁平电缆导体

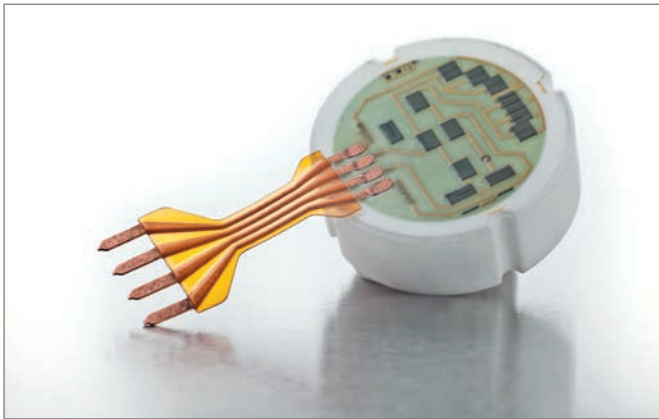
塑料焊接

金属焊接

切割

清洗

筛分



任务设置

具有 PCB (印刷电路板) 涂层的陶瓷部件应通过四轨 FCC (扁平电缆连接器) 导体接触到四个位置。期间要注意不能损坏陶瓷载体, 确保 PCB 涂层不会脱落。电接触电阻应尽可能低。

解决方案

使用纵向金属焊接技术解决了接触问题。M600 型金属焊接设备 (频率 35kHz, 功率 1200W) 的组件以及集成在特殊设备中的进料控制系统 ACC, 将 FCC 导体可靠且经济地焊接在陶瓷载体的 PCB 涂层上。

该配置的优点

35kHz 的高频率可确保陶瓷载体的温和振动载荷, 将损坏风险降至最低。焊接机架 M600 的紧凑型执行器集成在生产设备中, 十分节省空间。进料控制系统 ACC 提供灵活的焊接模式并与上级 PLC 控制系统相连。使用可选配的软件 Telso®Tools 可读取并保存过程数据。



该应用通过 M600 型线性超声波金属焊接设备 (35kHz/1200W) 的组件和特殊设备中的进料控制系统 ACC 实现。